

檔 號：

保存年限：

## 台中市電腦商業同業公會 函

地址：台中市昌平路一段 95-8 號 9 樓

承辦人：許富豪

電話：(04)22421717#235

傳真：(04)22421030

信箱：cody@tcca.org.tw

受文者：台灣電子製造設備工業同業公會

發文日期：中華民國 115 年 8 月 21 日

發文字號：中市電總字第 1150000098 號

速別：普通

密等及解密條件：

附件：活動 DM

主旨：檢送本會辦理數位發展部數位產業署指導之「企業面對歐盟 CRA 合規標準的商機」推廣講座資訊，敬請貴單位協助轉知並鼓勵所屬單位/企業/會員踴躍參與講座，請查照。

說明：

一、依據數位發展部數位產業署「晶片安全標準與檢測技術推廣講座」計畫辦理。

二、依據財團法人資訊工業策進會與本會執行之「晶片安全標準與檢測技術推廣講座」辦理。本計畫旨在協助國內產業掌握國際資安合規趨勢，並及早因應未來全球市場對產品安全與晶片安全之要求，特辦理旨揭研討會。

三、本次研討會以「掌握晶片安全到全球商機的全面對策」為核心，為協助企業掌握 CRA 法規趨勢、產品資安合規、晶片安全設計、檢測驗證及國際標準接軌等實務重點，特辦理旨揭講座，邀請相關領域專家從國際法規、晶片安全策略、檢測驗證與企業合規準備方向進行分享，協助企業提前盤點產品銷往歐盟與全球市場可能面臨之資安要求。活動資訊如下：

(一) 企業面對歐盟 CRA 合規標準的商機-掌握晶片安全到全球商機的全面對策

1. 時間：115 年 9 月 11 日（五）13:30 ~ 16:30。

2. 活動地點：集思竹科會議中心 2F 達爾文廳(新竹市東區科學里工業東二路 1 號)。

3. 參與方式：免費參加，採實體及線上同步辦理

4. 合適對象：產品合規與資安管理人員、晶片設計與系統開發工程師、IC 設計業、ODM/OEM、IPC、工控、物聯網、車用電子、資通訊產品製造商，以及關注 CRA 合規、晶片安全、產品資安與國際標準接軌之相關從業人員參與。

5. 講座重點：

a. 多重國際法規下的晶片策略與整合應用。

b. CRA 最新發展與企業合規準備重點。

c. 晶片安全核心檢測要項與驗證實務。

d. SESIP、FIPS 等晶片安全驗證之實務經驗與挑戰。

四、敬請貴單位惠予公告周知，並協助轉知所屬會員廠商之產品合規、資安管理、研發設計、韌體開發、法務、PSIRT、檢測驗證及海外市場相關部門派員參加。即日起請至本會指定線上報名系統

(<https://ievents.iii.org.tw/EventS.aspx?t=0&id=3464>) 或掃描附件宣傳海報之 QR Code 辦理報名。如有活動相關疑問，請聯絡承辦人員許先生(電話：04-22421717#235，cody@tcca.org.tw)。

五、檢附本次活動 DM 乙式。

正本：台灣電子製造設備工業同業公會

副本：台中市電腦商業同業公會

理事長 李國榮



# 企業面對歐盟CRA 合規標準的商機

—掌握晶片安全到全球商機的全面對策



免費實體/線上會議  
掃描QRCode立即報名

\*主辦單位保有審核之權利  
實際報名成功與否待主辦單位活動前通知

2026/09/11 (五)  
13:30 ~ 16:30

集思竹科會議中心2F達爾文廳  
(新竹市東區科園里工業東二路1號)

| 時間          | 主題                                   | 講者                                                                         |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13:30-14:10 | 多重法規下的全球晶片資安合規策略：<br>跨國際標準架構的映射與整合佈局 | 安華聯網科技股份有限公司<br>周辰儒 Bruce Chou<br>Technical Solution Manager of DEKRA      |
| 14:10-14:50 | 從晶片安全到全球市場：<br>掌握 EU CRA 最新法規進展與合規策略 | 台灣檢驗科技股份有限公司<br>李培寧 Kenny Lee<br>SGS Head of Cybersecurity Laboratory      |
| 14:50-15:00 | Break                                |                                                                            |
| 15:00-15:40 | 晶片資安實測指南：<br>核心檢測要項與驗證實務說明           | 鑑智實相科技股份有限公司<br>林高裕 Gary Lin<br>COO of Digiforen                           |
| 15:40-16:10 | CRA 從入門到實戰                           | 華邦電子股份有限公司<br>戴士雄 Alistar Tai<br>Applications Engineering Manager, Winbond |
| 16:10-16:20 | 晶片安全課程需求清單分享                         | 財團法人資訊工業策進會<br>Institute for Information Industry                          |
| 16:20-16:30 | Q&A                                  |                                                                            |

※主辦單位保有最終修改、更改、活動解釋即取消本活動之權利。